

半导体设备及材料展览会-2024年半导体展会展位火热抢购中

产品名称	半导体设备及材料展览会-2024年半导体展会展位火热抢购中
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

2024第6届深圳国际半导体技术展览会暨应用展览会展览时间：2024年6月26-28日
展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

组织机构：中国通信工业协会、深圳市半导体行业协会、广东省集成电路行业协会、广州市半导体行业协会、江苏省半导体行业协会、浙江省半导体行业协会、成都市集成电路行业协会

2024第6届深圳国际半导体技术展览会暨应用展览会已形成从半导体设备和材料研制与生产、集成电路与新型分立器件设计、加工制造与封装测试、以及系统应用的较为完整产业链，打造国内的集成电路设计业强省和国家重要的半导体及集成电路产业基地，做大做强半导体及集成电路产业集群，支撑制造强省、网络强省、数字经济强省建设。本次会议集合了半导体及集成电路产业链涵盖了设计业、晶圆制造、封装测试、支撑业，形成了从半导体设备和材料的研制与生产，到集成电路设计、制造、封装测试及系统应用的产业链条。”

SEMI-e以“芯机会?智未来”为主题，汇聚众多和学者，进一步加强全球集成电路产业的交流与合作，围绕中国国际集成电路产业与应用，立足深圳、辐射全国，旨在集中展示集成电路产业发展成果，加快高端芯片设计、关键器件、核心装备材料、EDA设计工具等产业链关键环节攻关突破，加强珠三角产业链协作，逐步形成综合性集成电路产业集群，打造华南集成电路产业交流与贸易平台，推动华南集成电路产业集聚区更快更好发展。本届展会顺应产业发展趋势，服务于十几个新兴行业应用。

参展范围：

IC设计专区

EDA、IP设计、嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混合信号电路设计、集成电路布局设计等

集成电路制造专区

晶圆制造厂、晶圆代工厂、模拟集成电路、数字集成电路和数模混合集成电路制造等。

封装测试专区

测试探针台、测试机、分选机、封装设备、封装基板、引线框架键合丝等。

半导体材料专区

硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘合材料等。

设备制造专区

减薄机、单晶炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备清洗设备、切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台等。

电子元器件专区

电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路压电、晶体、石英、电子功能工艺专用材料电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。

智慧电源专区

微波射频、半导体LED、离子电源、共享智慧充电、通信电源、光伏/风电/储能电源设计、功率变换器磁技术等。

政府、产业园专区

全国各地政府组团及集成电路、半导体相关领域高科技产业园区。

2024年6月26-28日，半导体设备展区全新升级。xingyeshuanjia齐聚鹏城，推动国内外产业链材料设备技术交流，提升产业竞争力。智能制造技术和设备、新的模拟设计、验证技术的设备及材料处理技术.....在SEMI-e现场应有尽有！